

第17回光・レーザー技術展、 タカノブースへ是非ともお立ち寄りください。

Takano

展示内容

UV(紫外)レーザー マーキング/微細加工

UVレーザーマーカ

UVレーザー加工機

UVレーザーの特徴である精密微細加工技術を活かしたマーキング・加工機を展開しております。ウエハ/基板へのマーキング、カテーテルの穴あけ加工をはじめとして様々なご要望にお応えします。

フレキシブルOLEDディスプレイ製造向けレーザーシステム

レーザーリフトオフ

レーザーカット

レーザーリペア

ついに実用化が進み、今後ディスプレイの主流として期待されるフレキシブルOLEDディスプレイの製造工程で必要とされるレーザーリフトオフ、レーザーカット、レーザーリペアに取り組んでおります。取り組み内容をパネル出展いたします。

本案内状持参の方に**粗品**をご準備しております。ブースへのご来場を心よりお待ちしております。

TAKANOブース
展示会出展のご案内

Photonix2017 光・レーザー技術展 内
第10回 **レーザー加工技術展**

会期 2017年4月5日(水)～7日(金)

会場 東京ビッグサイト 東ホール

展示コーナー 見どころはこちら!

UV(紫外)レーザー

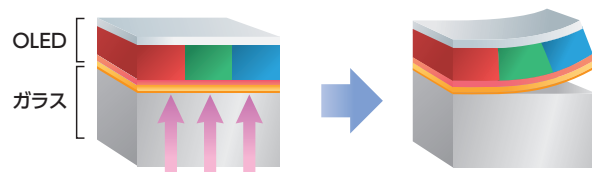
	レーザーマーカ CHARIS	レーザー加工機 VGAIA
発振波長	266nm (YAG第四高調波)	355nm (YVO4第三高調波)
励起方法	LD励起	LD励起
平均出力	200mW@10kHz	2W/15Wタイプから選択 ※レーザー単体出力値
パルス幅	<7ns@10kHz	<10ns@80kHz(2Wタイプ) <25ns@100kHz(15Wタイプ)
集光スポット径	10μm～	30μm～
ガルバノスキャン エリア	30mm□	300mm□ 3D±30mm



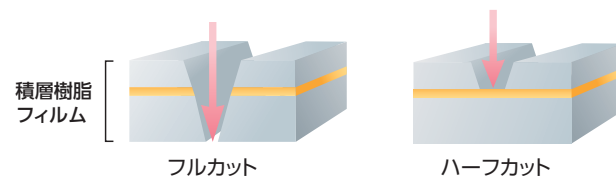
実機展示

フレキシブルOLEDディスプレイ製造向けレーザーシステム

マルチショートラインビームによる高速「レーザーリフトオフ」



繊細で熱影響の少ない「レーザーカット」



展示会概要

Photonix2017 光・レーザー技術展 内

第10回 レーザー加工技術展

会期 2017年4月5日(水)～7日(金)

会場 東京ビッグサイト

主催 リードエグジビジョンジャパン株式会社

小間番号 46-37

会場地図



Takano

出展製品情報はこちら > <https://www.takano-kensa.com/>

本展示に関するお問い合わせ、当日のアポイントに関するご連絡は下記連絡先、または弊社営業までご連絡ください。
担当：早川(Tel: 03-3253-8261 / Mail: shuhei.hayakawa@takano-net.co.jp)